

T810LS-F2

万兆光纤以太网卡



T810LS-F2 是同泰怡基于 Intel E810-XXVAM2 芯片开发的 25G 光纤以太网卡，通过创新和多种先进技术提高了应用程序效率和网络性能，改进了对虚拟化的支持，旨在为通信、云和企业 IT 等网络解决方案提供广泛的互操作性、性能优化和更高的敏捷性。

关键参数

- PCIe 4.0 x 8 主机接口和 25GbE 双端口传输
- 同时支持 iWARP 和 RoCEv2 RDMA，用于低延迟、高吞吐量的工作负载
- 动态设备个性化 (DDP) 提高了数据包处理效率
- 针对高效数据包处理进行了优化的数据平面开发套件 (DPDK)
- 支持网络虚拟化卸载，包括 SR-IOV、Geneve、VXLAN 和 NVGR

技术规格

功能	规格参数
网卡型号	T810LS-F2
产品形态	PCIe HHHL (可选半高或全高挡片)
网络控制器	Intel E810-XXVAM2
主机接口	PCIe 4.0 x8
端口&速率	Dual-Port SFP28 25/10GbE
管理功能	支持 MCTP over PCIe 支持 PXE
CPU 卸载	TCP Segment Offload (TSO) UDP Segment Offload (USO) Large Segment Offload (LSO) Checksum Offload (TCP/UDP/IP)
虚拟化技术	支持片上 QoS 和流量管理 支持灵活端口分区 (FPP) 支持虚拟机设备队列 (VMDq) 支持 SR-IOV
RDMA	iWARP and RoCEv2
以太网存储	iSCSI, NFS
先进技术	支持应用设备队列 (ADQ)功能 支持动态设备个性化(DDP) 支持 DPDK
典型功耗	12.1W
最大功耗	13.7W
操作系统支持	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、VMware ESXi、Citrix XenServer 等主流服务器操作系统
工作温度	0°C - 55°C
存储温度	-40 °C ~ 70 °C
存储湿度	最大 90%(35°C 相对湿度下不凝结)

以业务目标为基础的数据中心解决方案

让您更充分地利用IT和企业解决方案，帮助降低IT复杂性、削减成本并提高效率。我们利用您当前技术的同时将针对您的需求量身定制的创新技术无缝地融入进来，以您应用的业务为基础，为您构建高效，敏捷，开放，智慧的数据中心软硬件一体解决方案，简化您的IT，解决您的业务难题，并持续为您创造价值。有关详情，请与您的销售代表联系。**

有关详细信息，请访问 www.ttyinfo.com

本文件中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。同泰怡声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权益。本文内容仅供参考。同泰怡保留对本文所述的任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。本文内容按原样提供，不含任何形式的明示或暗示保证。